

investor

newsletter

IM FOKUS

- 2-3 ■ „Flash“ im Rampenlicht: Infineon will zu den Führenden gehören

TRENDS & THEMEN

- 4-5 ■ Joint Venture für Glasfaser-Komponenten
■ Infineon, IBM und Chartered entwickeln gemeinsam 65-Nanometer-Technologie
■ Investor Relations unter neuer Leitung
■ Hauptversammlung 2004: Infineon peilt Gewinnzone an
■ Fusion in Taiwan: ADMtek übernommen
■ Snowboarden mit eingewebtem Sound: Erstmals alltagstaugliche elektronische Kleidung
■ Neues Design-Zentrum in China

ENTWICKLUNG & PRODUKTE

- 6-7 ■ Stromsparen für Leuchtstoffröhren
■ Chips lesen blitzschnell
500 Funk-Etiketten
■ Hochgeschwindigkeits-Internet per Satellit
■ Vorreiterrolle bei grünen Produkten
■ Flexibelster Chip für Ethernet vorgestellt
■ Fortschritte bei organischen Elektronikkomponenten
■ Datentransfer mit vorhandenem Glasfasernetz
■ In zwei Wochen zur neuen Karte

ZAHLEN & FAKTEN

- 8-11 ■ Analyse der Geschäftsergebnisse

AUSBLICK

- 11-12 ■ Ausblick auf das Geschäftsjahr 2004
■ Relative Performance der IFX-Aktie seit Beginn des Geschäftsjahres 2003

Chic verkabelt: Bei der ersten intelligenten Jacke verstaut

Infineon die Tastatur im Ärmel und die Kopfhörer im Kragen.

Pünktlich zur nächsten Wintersaison soll es sie zu kaufen geben.



„FLASH“ IM RAMPENLICHT: INFINEON WILL ZU DEN FÜHRENDEN GEHÖREN

Enormes Wachstum im Flash-Markt verspricht stabile Säule in der Speicherproduktion



Sie passen in jede Westentasche, und doch haben sie eine Speicherkapazität, die noch vor wenigen Jahren jedem Personalcomputer zur Ehre gereicht hätte: So genannte Flash-Memory-Bausteine, die den Elektronikmarkt geradezu im Sturm erobern. Auf der Konsumgüterseite stecken sie in Digitalkameras, in Mobiltelefonen, in MP3-Playern und PDAs, in der Arbeitswelt etablieren sie sich vor allem als so genannte USB-Sticks. Mit ihnen muss keine schwere Technik mehr über die Flure gewuchtet werden; große Datenmengen hängt man sich einfach an den Schlüsselbund, trägt sie als Halskette oder im Portmonee. Am Zielcomputer in den USB-Port gesteckt, werden die Daten sofort wieder zugänglich. Außerdem können Flash-Karten Software speichern, etwa in Computern oder auch in Mobiltelefonen.

Die Marktforscher von Gartner Dataquest erwarten im Jahr 2004 ein Marktwachstum von 30,8 Prozent; bei 4,4 Milliarden US-Dollar soll der weltweite Umsatz mit Daten-Flash-Produkten in diesem Jahr liegen. In den nächsten fünf Jahren könnte das durchschnittliche Wachstum demnach bei jährlich rund 18 Prozent liegen. Ein Zukunftsmarkt, mit dem sich Infineon schon seit einiger Zeit auseinander setzt:

Infineon Technologies kündigte den weltweit ersten NAND-kompatiblen Flash-Chip auf Basis der TwinFlash™-Technologie an. Der 512-Mbit-Twin-NAND-Chip basiert auf Saifuns NROM-Technologie, bei der zwei (Twin) separate Bits in einer Transistorzelle gespeichert werden.

Bereits im Mai 2001 hat Infineon ein Joint Venture mit dem israelischen Unternehmen Saifun Semiconductors Ltd. mit dem Ziel gegründet, Flash-Speicher zu entwickeln, zu produzieren und zu vermarkten. Im Februar 2003 wurde dann daraus die Infineon Technologies Flash GmbH & Co. KG gegründet, an der Infineon 70 Prozent hält und die derzeit rund 120 Mitarbeiter zählt.

Flash-Bausteine – das sind nicht-flüchtige Speicherchips, die die Informationen auch dann behalten, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Da sie im Gegensatz zur Festplatte oder Diskette ohne bewegliche Teile auskommen, sind sie ziemlich robust. Unterschieden werden zum einen Programm-Flash-Speicher (auch Code-Flash oder NOR genannt), die Software speichern, etwa in Personalcomputern und Mobiltelefonen, zum anderen Daten-Flash-Speicher (NAND), die – wie der Name schon sagt – Daten speichern, etwa Adressen in PDAs, Fotos in Digitalkameras oder Musik in MP3-Playern.

Was Saifun, das Halbleiterunternehmen aus dem israelischen Netanya, in Sachen Flash als Partner attraktiv macht, ist vor allem seine revolutionäre NROM-Technologie, die bereits seit längerem für NOR-Speicher eingesetzt wird. Statt nur einem Bit passen bei diesem Verfahren zwei Bits in eine Zelle, wodurch sich die Speicherbausteine insgesamt besonders klein halten lassen. Dem Infineon-Saifun-Gemeinschaftsunternehmen ist es in Dresden nun erstmals gelungen, diese Technologie auch auf Daten-Flash-Speicher zu übertragen. TwinFlash hat das Unternehmen seine

Neuentwicklung getauft, wegen der zwei Bits pro Zelle. Die NAND-kompatiblen Daten-Speicher sind 40 Prozent kleiner als die der Konkurrenz und kommen noch dazu mit weniger Belichtungsvorgängen zustande als vergleichbare Produkte, die nur ein Bit pro Zelle speichern können.

In der Fertigung kann Infineon mit Synergien punkten, die in der Dresdner Chipfertigung entstehen: Infineon kann je nach Auftragslage flexibel zwischen der Fertigung von DRAM- und von Flash-Speichern hin- und herschalten, beide entstehen mit dem gleichen Equipment; zusätzliche Investitionen sind also kaum nötig.

Bis Ende 2004 sollen mit mehr als 10.000 Waferstarts pro Monat Infineon-Flash-Speicher entstehen, zunächst in 170-Nanometer-Fertigung; an der 110-Nanometer-Technologie wird bereits gearbeitet. Damit sollen zum einen die Kosten weiter sinken, zum anderen soll sich die Speicherdichte so weiter erhöhen – auf bis zu zwei Gigabit. Für die weitere Zukunft sind noch höhere Dichten geplant. Der Markt für Flash-Speicher wird es danken, denn das enorme Wachstum in diesem Sektor schreit förmlich nach potenten Lieferanten. Insgesamt also stehen die Zeichen gut, dass Infineon sein Ziel erreicht: Im Jahr 2007 zu den drei größten Flash-Lieferanten der Welt zu gehören.

EINIGE ANWENDUNGEN FÜR FLASH-SPEICHER

- Digitalkameras: Speicherung von Hunderten von Bildern mit hoher Auflösung; Verbindung zur Digitalkamera und Darstellung in Echtzeit ohne Filmentwicklung.
- Mobiltelefone, PDAs, MP3-Player: Musik, Daten und Bilder lassen sich speichern, abspielen und auf andere mobile oder stationäre Geräte übertragen. Die Flash-Karten sind handlich klein und robust und der ideale Begleiter für mobile Endgeräte.
- Typische Karten Produkte für Digitalkameras und Mobiltelefone sind SD, MMC, CF, Memory Stick oder SmartMedia Karten.
- USB-Sticks: Diese Speicher lassen sich einfach an den USB-Port von Computern anschließen und übernehmen die Funktion einer Diskette oder CD: Daten können darauf gespeichert und zu anderen Computern transportiert werden.

JOINT VENTURE FÜR GLASFASER-KOMPONENTEN

Um Glasfaser-Komponenten geht es bei dem neuen Joint Venture von Infineon und der United Epitaxy Company (UEC) aus Taiwan. Beide Partner bringen ihre Glasfasertechnologien per Lizenz in das neue Unternehmen ein, um spezielle Optochips zu entwickeln und herzustellen. Entstehen sollen so High-End-Mikrosysteme und -Komponenten, die wiederum in Glasfaser basierte Produkte zur Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung in Sprach- und Datenkommunikations-Netzen eingesetzt werden. Als Standort des Joint Ventures ist das bereits vorhandene Werk von UEC im taiwanischen Hsinchu Science-based Industrial Park vorgesehen. Die gesamten Investitionen werden sich in den nächsten fünf Jahren auf zirka zwölf Millionen US-Dollar belaufen. Bei einer Vollauslastung von bis zu 100 Wafer-Starts pro Woche wird das Unternehmen Arbeitsplätze für rund 120 Beschäftigte bieten. Die Serienproduktion soll im vierten Quartal 2004 anlaufen.

INFINEON, IBM UND CHARTERED ENTWICKELN GEMEINSAM 65-NANOMETER-TECHNOLOGIE

Infineon vertieft seine Kooperation mit anderen Größen der Halbleiterbranche: Gemeinsam mit Chartered Semiconductor Manufacturing aus Singapur, das zu den drei führenden Halbleiter-Auftragsfertigern zählt, und mit IBM beabsichtigt Infineon, die Foundry-Technologie für Chipstrukturen von 65 Nanometern sowie Hochleistungschips mit niedriger Energieaufnahme zu entwickeln. Erwogen wird, die Zusammenarbeit auf die 45-Nanometer-Prozesstechnik und damit die übernächste Fertigungsgeneration auszudehnen. Die Technologiepartnerschaft, die im August 2003 vertraglich besiegelt wurde, führt die Kompetenzen der beteiligten Unternehmen zusammen und soll dazu dienen, sofort einsetzbare Chip-Designs zu entwickeln. Für Infineon bietet sie eine attraktive und risikoarme Outsourcing-Option, um in Zukunft den Bedarf an 65-Nanometer-Produkten decken zu können. An dem Projekt, das in einem Entwicklungslabor von IBM im Bundesstaat New York angesiedelt ist, sind 200 Ingenieure der drei Unternehmen beteiligt.



INVESTOR RELATIONS UNTER NEUER LEITUNG

Dominik Asam (34) hat im September 2003 die Leitung von Investor Relations bei Infineon übernommen. Sein Verantwortungsbereich erstreckt sich zudem auf die Gebiete Mergers & Acquisitions sowie Infineon Ventures. Vor seinem Wechsel zu Infineon war Asam seit 1996 bei Goldman Sachs in der Investment Banking Division in London und New York tätig.

HAUPTVERSAMMLUNG 2004: INFINEON PEILT GEWINNZONE AN

Eine insgesamt positive Bilanz des Geschäftsjahres 2003 hat Vorstandsvorsitzender Dr. Ulrich Schumacher auf der Infineon-Hauptversammlung gezogen, vor allem angesichts der leichten Erholung am Halbleitermarkt. Trotz der gesunkenen Chippreise und des schwachen Dollarkurses, verzeichnete das Unternehmen im Geschäftsjahr 2003 im Vergleich zum Vorjahr einen Umsatzanstieg um 26 Prozent auf 6,15 Milliarden Euro. Von den größten Halbleiterherstellern der Welt ist Infineon damit besonders schnell gewachsen. Nach neun Verlustquartalen in Folge hat das Unternehmen im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2003 mit 67 Millionen Euro bzw. mit 70 Millionen Euro im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2004 erstmals wieder positive EBIT-Ergebnisse erzielt. Während im Geschäftsjahr 2003 ein negatives EBIT von 299 Millionen Euro hingenommen werden musste, peilt Infineon für 2004 die Rückkehr in die Gewinnzone an. Auf der Hauptversammlung hatte das Aktienoptionsprogramm des Vorstands die Kritik einiger Anleger auf sich gezogen. Vorstand und Aufsichtsrat wurden bei zahlreichen Enthaltungen und wenigen Gegenstimmen entlastet.



FUSION IN TAIWAN: ADMTEK ÜBERNOMMEN

Erstmals übernimmt Infineon ein asiatisches Unternehmen: Mit ADMtek Inc. aus dem taiwanesischen Hsinchu wird ein Spezialist für Netzwerk- und Kommunikationssysteme in den Konzern integriert. Der Chipdesigner, der nicht über eigene Fertigungsanlagen verfügt, wird den Geschäftsbereich Drahtgebundene Kommunikation stärken. Unter dem Namen Infineon-ADMtek Co. Ltd. soll in Hsinchu ein neues Unternehmen gegründet werden, um Schaltkreise für Breitbandanschlüsse zu entwickeln. Infineon zielt dabei darauf, in den Markt für Home-Gateway-Systeme einzusteigen, wobei ADMtek auf Teilnehmeranschluss-einrichtungen und Infineon auf Vermittlungsstellentechnik spezialisiert ist. Dabei liegt der Standort günstig – in der Nähe der am schnellsten wachsenden Märkte für Breitbandlösungen, China und Japan, und darüber hinaus förmlich in der Nachbarschaft taiwanesischer Original Design Manufacturing Unternehmen, deren Anteil am weltweiten Markt für Breitband-Modems und Router-CPE bei über 70 Prozent liegt. Zudem ergänzen sich beide Unternehmen in der Kundenstruktur. Das neue Unternehmen Infineon-ADMtek wird seinen Kunden Komplettlösungen für Multimedia-Home-Gateways anbieten können, die sowohl drahtgebundene als auch drahtlose Breitbandkommunikationsdienste unterstützen. Infineon wächst mit der Übernahme überdies ein Unternehmen mit einer effizienten Kostenstruktur zu, zu dem ein leistungsfähiges Entwicklungszentrum gehört. Teil der Transaktion, die einen Wert von 80 Millionen Euro hat, ist eine langfristige Liefervereinbarung: Danach beliefert Infineon den ADMtek-Hauptanteilseigner, die Accton Technology Corporation und ihr verbundene Unternehmen, mit Produkten für Breitband-Lösungen. Die Fusion wird voraussichtlich im April 2004 perfekt sein; sie bedarf noch der amtlichen Zustimmung und eines positiven Votums der ADMtek-Aktionäre. Infineon ist der erste ausländische Investor, der mehrheitlich ein taiwanesisches Halbleiterunternehmen übernimmt. Die Akquisition liegt dabei ganz im Sinne der Wachstumsstrategie von Infineon, die den Ausbau der Präsenz in Asien ausdrücklich vorsieht.

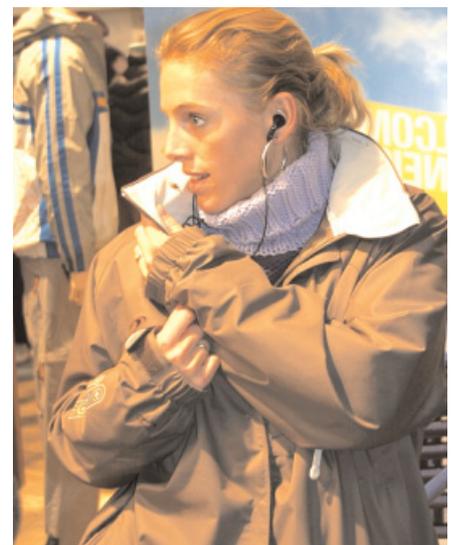
SNOWBOARDEN MIT INGEWEBTEM SOUND: ERSTMALS ALLTAGSTAUGLICHE ELEKTRONISCHE KLEIDUNG

Es ist soweit: Das erste Stück Kleidung mit eingewebten Mikrochips wird bald auf der Stange hängen. Speziell an Snowboarder richtet sich dieses erste Angebot von Elektronik zum Anziehen, das Infineon gemeinsam mit dem Sportausrüster O'Neill auf den Weg gebracht hat. In dessen Winterkollektion 2004/05 wird man eine Jacke mit eingewebtem Chipmodul finden, das sowohl MP3-Player als auch Bluetooth-Chip fürs Mobiltelefon ist. Gesteuert wird das Modul mit einer Stofftastatur, mit der es über leitende Stoffbahnen verbunden ist. Für den richtigen Klang sorgen Stereolautsprecher, die in den Helm eingebaut sind. Und um zu telefonieren, steuert der Bluetooth-Chip das Handy an. Das Mikrofon dafür ist in den Kragen angenäht, die Stereoanlage wird zum Headset. Der Jacke, die auf den Namen „THE HUB“ hört, können weder Waschen noch Bügeln etwas anhaben. Und auch den rauen Bedingungen beim Snowboarden ist das alltagstaugliche Kleidungsstück gewachsen.

Die Geräte selbst zur Kleidung werden zu lassen – das erscheint als logischer Schritt in einer technologischen Entwicklungskette, die zu einer immer stärkeren Miniaturisierung von Geräten führt. Infineon ist führend auf diesem Gebiet und empfiehlt sich gerade mit diesem Produkt erneut als Lösungsanbieter unter den Halbleiterunternehmen. Der Markt könnte es danken: Allein für das Jahr 2007 geht die Venture Development Corporation davon aus, dass mit „intelligenten textilen Materialien“ weltweit mehr als eine Milliarde Euro umzusetzen sind. Seitdem Infineon die neue Technologie vorgestellt hat, haben mehr als 200 Unternehmen aus der Textilwirtschaft Interesse an konkreten Projekten bezeugt. So wird derzeit gemeinsam mit den Teppichwerken Vorwerk am Prototyp eines „intelligenten Teppichs“ gearbeitet.

NEUES DESIGN-ZENTRUM IN CHINA

Infineon setzt auf den Zukunftsmarkt China: Ein neues Tochterunternehmen in Xi'an wurde gegründet, vor allem, um innovative Applikationen für die Kommunikationsbranche und für die Automobil- und Industrieelektronik zu entwickeln. Das Entwicklungszentrum, das von Jean-Loup Leclère geleitet wird, soll bis 2007 mehr als 1.000 Mitarbeiter beschäftigen und damit zu einem der größten in Asien ausgebaut werden. Die Präsenz im Westen Chinas ist dabei von strategischer Bedeutung: Die gesamte Wertschöpfungskette in China kann weiter optimiert, das Mitarbeiterpotenzial besser ausgeschöpft werden. Insgesamt soll die Mitarbeiterzahl in China von derzeit etwa 800 auf über 3.000 erhöht werden. Infineon will mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar investieren und plant, binnen vier Jahren zu einem der vier größten Halbleiterunternehmen des Landes aufzusteigen.





STROMSPAREN FÜR LEUCHTSTOFFRÖHREN

Mit einem neuen Infineon-Chip werden Leuchtstoffröhren in Büros, Einkaufszentren oder Fabrikhallen in Zukunft viel Strom sparen können. Der LightMOS-Chip wird Teil des Vorschaltgeräts, das das fluoreszierende Gas zum Leuchten bringt. Bis heute sind etwa 80 Prozent aller Leuchtstoffröhren mit Vorschaltgeräten ausgestattet, die magnetisch mit Spulen, Kondensator und einem Zünder arbeiten. Dank der LightMOS-Technologie sinkt der Energiebedarf um bis zu 25 Prozent, da Durchlass- und Schaltverluste auf ein Minimum reduziert werden. Erhöht werden zudem Zuverlässigkeit und Komfort, denn Leuchtstoffröhren lassen sich zukünftig wie Glühlampen ohne Flackern zünden und sind dann sogar dimmbar. Bis 2005 wird der weltweite Bedarf an derartigen Chips auf rund 600 Millionen Stück geschätzt.

VORREITERROLLE BEI GRÜNEN PRODUKTEN

Besser, als das Gesetz es vorschreibt: Seit Herbst 2003 bietet Infineon blei- und halogenfreie DRAM-Komponenten an und stellt die Fertigung von Speichermodulen schrittweise auf umweltfreundliche Technologien um. Damit greift das Unternehmen rechtlichen Auflagen der Europäischen Union vor: Ab Juli 2006 untersagt die „Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe“, beispielsweise Blei einzusetzen. Eine andere Regelung schreibt Anbietern von Elektronikprodukten vor, ab 2007 gebrauchtes Gerät umweltfreundlich zu entsorgen. Wird bereits bei ihrer Herstellung auf blei- und halogenhaltige elektronische Bauelemente verzichtet, wird das anschließende Recycling einfacher und kostengünstiger. Infineon-Kunden ist es schon heute möglich, die umweltverträglichen Elektronikkomponenten zu testen.

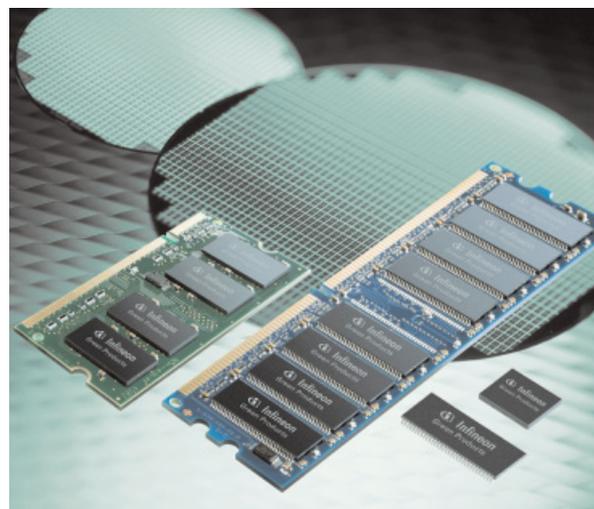
CHIPS LESEN BLITZSCHNELL 500 FUNK-ETIKETTEN

In weniger als einer Sekunde bis zu 500 elektronische Labels lesen oder beschreiben – das macht Funketiketten zur neuen Konkurrenz für den Barcode im Handel. Durch ständiges Umschalten zwischen acht verschiedenen Funkkanälen sind die neuen Infineon-Chips 25mal schneller als bisherige Produkte. Sie erfassen Objekte auch dann zuverlässig, wenn diese sich schnell bewegen. Das macht sie für viele Logistikwendungen interessant - von der Gepäckabfertigung am Flughafen über den Warenhandel und -versand bis hin zum Einsatz bei Kuriere- und Postdiensten und in der Fließbandproduktion. Die Chips werten die Funksignale mit der PJM-(Phase-Jitter-Modulation-)Technologie des australischen Partners Magellan aus und kommen selbst mit einer Transportbandgeschwindigkeit von 15 Kilometern pro Stunde zurecht.



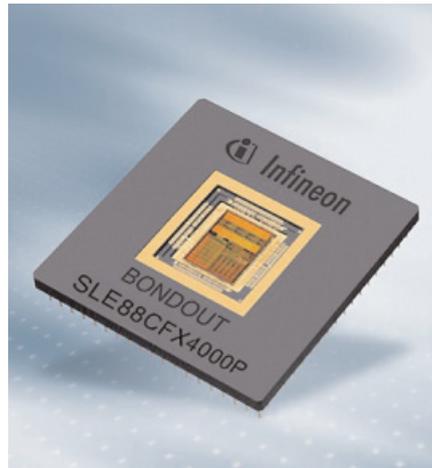
HOCHGESCHWINDIGKEITS-INTERNET PER SATELLIT

Breitband-Dienste abseits städtischer Ballungsräume sind jetzt weitaus schneller und kostengünstiger als bisher möglich. Ein Satelliten gestütztes System, das Infineon gemeinsam mit ViaSat aus den USA und dem taiwanesischen Unternehmen ZyXEL entwickelt hat, ermöglicht Hochgeschwindigkeits-Internet, Multimedia oder firmeninterne Netzwerke auch ohne die herkömmlichen drahtgebundenen Zugangslösungen. Bei dem System, das auf den Namen „Constellation“ getauft wurde, werden die Daten innerhalb des Gebäudes mit der von Infineon patentierten VDSL-Technik übertragen. Genutzt wird dafür das vorhandene Kupferkabel-Telefonnetz. Somit ist das System binnen weniger Stunden betriebsbereit, hohe Investitionen in neue Infrastrukturen entfallen. „Constellation“ kann damit selbst für Anwender in städtischen Bereichen eine Alternative zu terrestrischen Netzwerken bieten.



IN ZWEI WOCHEN ZUR NEUEN KARTE

Höchstens zwei Wochen dauert es in Zukunft, dass Infineon Chipkartenherstellern kundenspezifische Sicherheitscontroller bereit stellen kann - das ist dreimal schneller als bisher. Möglich wird dies durch ein neues Speicherkonzept: Betriebssystem, Software und sonstige Programme werden bei den neuen Chipkartencontrollern in einem flexiblen Speicher abgelegt. Damit können Daten und Anwendungen nachträglich aufgeladen werden; neue Karten lassen sich schnell und kundenspezifisch konfigurieren. Zudem genügt ein integrales Sicherheitskonzept höchsten Anforderungen – sowohl beim physikalischen Schutz als auch bei der Datenverschlüsselung.



Dieses Modul macht Tempo:
Höchstens zwei Wochen dauert es in Zukunft, dass Infineon Chipkartenherstellern kundenspezifische Sicherheitscontroller liefern kann.

DATENTRANSFER MIT VORHANDENEM GLASFASERNETZ

Daten per Hochgeschwindigkeit ohne kostenintensive neue Infrastruktur: Ein neues Transceiver-Modul von Infineon macht's möglich. Es lässt sich auf schmalbandigen Multimode-Glasfasern fehlerfrei übertragen – auf solchen Netzen beruhen rund 80 Prozent der Unternehmensinfrastrukturen weltweit. Bis zu 10-Gigabit-Ethernet können die neuen, so genannten XPAK-Module dadurch bis zu 300 Meter fehlerfrei übertragen, ohne dass in teure Multimode-Glasfasern mit hoher Bandbreite investiert werden müsste. Erste Muster werden noch im ersten Halbjahr 2004 verfügbar sein.

FORTSCHRITTE BEI ORGANISCHEN ELEKTRONIK-KOMPONENTEN

Organische Transistoren, Schaltungen und Speicher könnten zukünftig Silizium-Elektronikelemente ergänzen, besonders bei Massenprodukten und kostenkritischen Anwendungsbereichen. Infineon-Forscher haben Leistung, Zuverlässigkeit und Temperaturverhalten solcher Bauelemente verbessert. Sie haben molekulare Dünnschicht-Transistoren hergestellt, die bei einem ultra-dünnen Gate-Dielektrikum von 2,5 Nanometern auch bei Spannungen von nur einem Volt arbeiten. Nachgewiesen wurde zudem, dass sich organische Materialien mit einem Datenerhalt von mehr als einem Jahr auch als Speichermedium eignen. Skaliert werden kann dabei bis zu Strukturgrößen von weniger als 20 Nanometern. Präsentiert wurden die Forschungsergebnisse Ende vorigen Jahres auf dem IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM) in Washington.

FLEXIBELSTER CHIP FÜR ETHERNET VORGESTELLT

Sein Spektrum optischer Netzwerkkomponenten hat Infineon mit dem industrieweit flexibelsten Chip für Ethernet-over-SDH/SONET (EoS) erweitert. Anbietern von Daten- und traditionellen Telekommunikationsgeräten erlaubt der MetroMapper-622-Chip, flexible Systeme zu entwickeln, die den neuesten Ethernet-Transport-Anforderungen gerecht werden. Vorteile verspricht der neue Baustein auch unter Kostenaspekten: Line-Cards der nächsten Generation lassen sich damit weitaus preisgünstiger als bisher herstellen – durch Einsparungen bei Leistungsaufnahme, Designkomplexität und Softwareentwicklung.



Silbergrau und äußerst vielseitig:
Der Metro-Mapper-622-Chip ermöglicht branchenweit die flexibelsten Systeme, wenn es um Ethernet geht.

ANALYSE DER GESCHÄFTSERGEBNISSE

ERSTES QUARTAL DES GESCHÄFTSJAHR 2004

- Im ersten Quartal ging der Umsatz gegenüber dem Vorquartal um 8 Prozent auf 1,62 Milliarden Euro zurück; im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg der Umsatz um 13 Prozent.
- Der Konzernüberschuss im ersten Quartal lag bei 34 Millionen Euro und ist damit gegenüber 49 Millionen Euro im Vorquartal gesunken, gegenüber dem Minus von 40 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum jedoch stark verbessert.
- Das EBIT betrug 70 Millionen Euro – gegenüber 67 Millionen Euro im Vorquartal leicht gestiegen, gegenüber dem Minus von 29 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum stark verbessert.
- Trotz des anhaltenden Preisdrucks erreichten alle Geschäftsbereiche außer Drahtgebundene Kommunikation ein positives EBIT.

In fineon Technologies AG, der weltweit sechstgrößte Halbleiterhersteller, erzielte für das am 31. Dezember 2003 abgelaufene erste Quartal des Geschäftsjahrs 2004 einen Umsatz von 1,62 Milliarden Euro. Das entspricht einem Rückgang von 8 Prozent gegenüber dem vorausgegangenen Quartal und einer Steigerung von 13 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2003.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Konzernüberschuss von 34 Millionen Euro erzielt. Im Vorquartal lag der Konzernüberschuss bei 49 Millionen Euro und im vergleichbaren Vorjahreszeitraum ergab sich ein Konzernfehlbetrag von 40 Millionen Euro. Die Entwicklung des Konzernüberschusses gegenüber dem Vorquartal zeigte unter anderem höhere Erträge im Geschäftsbereich Sichere Mobile Lösungen und geringere Erträge im Geschäftsbereich Speicherprodukte.

Der Gewinn pro Aktie (verwässert und unverwässert) lag im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2004 bei 0,05 Euro. Im vorausgegangenen Quartal lag dieser Wert bei 0,07 Euro pro Aktie, während im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2003 ein Verlust von 0,06 Euro pro Aktie verzeichnet wurde.

Umsatzerlöse

Der Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal ist im Wesentlichen auf einen Rückgang der Preise in allen

AUSGEWÄHLTE DATEN DER QUARTALS-KONZERN-GEWINN-UND-VERLUSTRECHNUNG	3 MONATE ZUM	
	30.09.03	31.12.03
	in Mio. Euro	
Umsatzerlöse	1.756	1.623
Bruttoergebnis vom Umsatz	548	518
Forschungs- und Entwicklungskosten	- 297	-276
Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten	- 185	-174
Aufwendungen für Umstrukturierungsmaßnahmen	- 13	-2
Betriebsergebnis	36	68
Zinsergebnis	-32	-23
Auf konzernfremde Gesellschafter entfallende Ergebnisanteile	5	2
Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	35	47
Erträge (Aufwendungen) aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	14	-13
Konzernüberschuss	49	34
Gewichtete Anzahl ausstehender Aktien – unverwässert	721	721
Gewichtete Anzahl ausstehender Aktien – verwässert	732	733
Konzernüberschuss je Aktie – unverwässert und verwässert	0,07	0,05
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	67	70

Geschäftssegmenten und die negativen Einflüsse des schwächeren US-Dollars zurückzuführen.

Die Umsatzerlöse der einzelnen Geschäftsbereiche entwickelten sich im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2004 gegenüber dem vorausgegangenen Quartal und dem vergleichbaren Vorjahresquartal wie folgt:

- Der Geschäftsbereich Automobil- und Industrieelektronik erzielte im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 356 Millionen Euro. Das entspricht einem Rückgang von 1 Prozent gegenüber dem Vorquartal und einer Steigerung

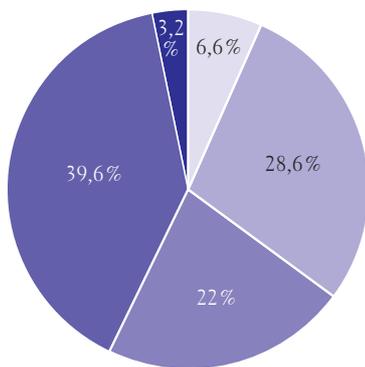
von 4 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Hauptursachen für den Umsatzrückgang im Vergleich zum vorausgegangenen Quartal sind der anhaltende Preisdruck und die Auswirkungen des schwachen US-Dollars.

- Der Geschäftsbereich Drahtgebundene Kommunikation erzielte im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2004 einen Umsatz von 107 Millionen Euro. Der Umsatz ging gegenüber dem vorausgegangenen Quartal um 12 Prozent zurück und stieg im Vergleich zum ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2003 um 1 Prozent. Der Rückgang im Ver-

AUSGEWÄHLTE KONZERN-BILANZDATEN	ZUM	
	30.09.03	31.12.03
Aktiva	in Mio. Euro	
Zahlungsmittel	969	585
Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.784	2.179
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	876	891
Vorräte	959	932
Umlaufvermögen	5.306	5.271
Sachanlagen	3.817	3.668
Bilanzsumme	10.805	10.756
Passiva		
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	149	142
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	877	818
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten	2.134	2.096
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	2.343	2.331
Summe Verbindlichkeiten	5.139	5.101
Eigenkapital	5.666	5.655

AUSGEWÄHLTE DATEN DER QUARTALS-KAPITALFLUSSRECHNUNG	3 MONATE ZUM	
	30.09.03	31.12.03
	in Mio. Euro	
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	442	320
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-255	-783
Mittelabfluss/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit	-45	79
Abschreibungen	364	328
Mittelabfluss für Sachanlagen	-195	-216

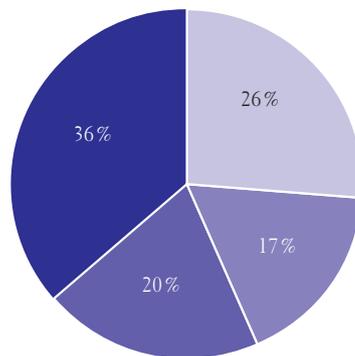
Segment-Umsatzerlöse in Mio. Euro für das Quartal zum 31.12.03



- Drahtgebundene Kommunikation: 107 Mio. Euro
- Sichere Mobile Lösungen: 465 Mio. Euro
- Automobil- und Industrieelektronik: 356 Mio. Euro
- Speicherprodukte: 643 Mio. Euro
- Sonstige und Konzernfunktionen: 52 Mio. Euro

Infineon: 1.623 Mio. Euro

Regionale Umsatzverteilung in Prozent für das Quartal zum 31.12.03



- Deutschland
- Übriges Europa
- Nordamerika
- Asien-Pazifik

gleich zum Vorquartal resultiert vornehmlich aus geringeren Umsätzen im Geschäft mit Glasfaserkomponenten, wurde aber teilweise durch das Wachstum bei Zugangsnetzprodukten ausgeglichen. Zu den weiteren negativen Einflüssen auf den Umsatz gehörte neben dem schwachen US-Dollar auch der anhaltende Preisrückgang. Im Bereich Zugangsnetzprodukte verzeichnete das Geschäft mit ADSL- und SHDSL-Lösungen ein beträchtliches Umsatzwachstum.

- Der Geschäftsbereich Sichere Mobile Lösungen erreichte im ersten Quartal einen Umsatz von 465 Millionen Euro und damit nahezu das gleiche Niveau wie im Quartal davor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg der Umsatz um 15 Prozent. Der Umsatz im abgelaufenen Quartal fiel damit wesentlich besser aus als erwartet. Die Ursache war ein saisonal bedingt starker Absatz von mobilen Kommunikationsgeräten. Dem gegenüber standen jedoch ein Umsatzrückgang durch das schwächere Projektgeschäft mit Sicherheitsprodukten und der Auslauf von Teilen des Geschäfts mit schnurlosen Telefonen sowie Aktivitäten im Bereich Galliumarsenid.

- Der Umsatz des Geschäftsbereichs Speicherprodukte lag im abgelaufenen Quartal bei 643 Millionen Euro und damit 16 Prozent unter dem Wert des vorausgegangenen Quartals, aber 19 Prozent über dem Wert des vergleichbaren Vorjahreszeitraums. Das reduzierte Absatzvolumen und der Preisrückgang gehörten ebenso zu den Ursachen für den Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal wie die negativen Auswirkungen des schwachen US-Dollars. Das geringere Umsatzvolumen ist die Folge einer Fokussierung auf Preisqualität in der Vertriebsstrategie sowie des flexiblen Einsatzes externer Fertigungskapazitäten.

■ Im Geschäftsbereich Sonstige stieg der Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2004 auf 47 Millionen Euro und nahm damit um 18 Prozent gegenüber dem Quartal davor und um 27 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum zu.

Der außerhalb Europas erwirtschaftete Umsatz erreichte einen Anteil von 57 Prozent am Gesamtumsatz gegenüber 59 Prozent im Vorquartal. Die Umsätze in Nordamerika machten 20 Prozent des Gesamtumsatzes aus, im Vergleich zu 24 Prozent im Vorquartal. Im asiatischen Markt wurden 36 Prozent des Gesamtumsatzes erwirtschaftet, gegenüber 34 Prozent im Vorquartal ein Anstieg.

Betriebsergebnis

Das EBIT (definiert als Ergebnis vor Zinsen und Steuern) betrug 70 Millionen Euro gegenüber 67 Millionen Euro im Quartal davor und verbesserte sich erheblich gegenüber einem Minus von 29 Millionen Euro im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Diese gute Entwicklung liegt im Rahmen unserer Erwartungen und stimmt mit unseren langfristigen Planungen überein. Wir konnten mit drei unserer vier Geschäftsbereiche positive Ergebnisse erzielen. Trotz des Preisverfalls und des anhaltenden Einflusses des schwächeren US-Dollars haben wir durch die Ausnutzung von Produktivitäts- und Kostenvorteilen unser EBIT weiter verbessert.

■ Das EBIT des Geschäftsbereichs Automobil- und Industrieelektronik stieg im Vergleich zum Vorquartal und zum ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2003 von jeweils 44 Millionen Euro auf 48 Millionen Euro. Die EBIT-Steigerung im Vergleich zum Vorquartal reflektiert vornehmlich die im vorausgegangenen Quartal erstmalige Konsolidierung von SensoNor und einmalige Aufwendungen in Verbindung mit dieser Akquisition. Darüber hinaus steigerte der Geschäftsbereich weiterhin seine Produktivität.

■ Im Geschäftsbereich Drahtgebundene Kommunikation lag der EBIT-Verlust mit minus 15 Millionen Euro über dem Verlust von minus 8 Millionen Euro im Vorquartal, hat sich jedoch gegenüber dem Wert von minus 42 Millionen Euro im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2003 wesentlich verbessert.

■ Trotz des nur geringfügig höheren Umsatzes konnte das EBIT im Geschäftsbereich Sichere Mobile Lösungen deutlich auf 14 Millionen Euro gesteigert werden. Im Vorquartal lag dieser Wert noch bei 4 Millionen Euro, im vergleichbaren Vorjahreszeitraum bei minus 28 Millionen Euro. Das verbesserte Quartals-EBIT reflektiert den optimierten Produktmix und die höhere Produktivität, die trotz des anhaltenden Preisdrucks erreicht wurde. Durch

■ Das EBIT im Geschäftsbereich Speicherprodukte betrug im letzten Quartal 57 Millionen Euro und lag somit unter dem Wert des Vorquartals von 134 Millionen Euro sowie über dem Wert von 31 Millionen Euro, der im vergleichbaren Vorjahreszeitraum erreicht wurde. Der im Vorquartal erzielte einmalige Gewinn aus dem Verkauf von ProMOS-Aktien, negative Effekte des Wechselkurses sowie – in einem geringeren Maße – die fallenden Preise und die geringere Bit-Nachfrage gehörten zu den wichtigsten Ursachen für den EBIT-Rückgang.

■ Das EBIT im Geschäftsbereich Sonstige lag bei minus 5 Millionen Euro gegenüber einem Minus von 26 Millionen Euro im Vorquartal und einem Plus von 6 Millionen Euro im ersten Quartal des vorangegangenen Jahres. Die EBIT-Steigerung im Vergleich zum vorausgegangenen Quartal kam durch die verbesserte Performance in der Sparte ASIC & Design Solutions (ADS) und die gegenüber dem Vorquartal geringeren Wertberichtigungen zu Stande.

■ Bei den Konzernfunktionen verbesserte sich das EBIT im abgelaufenen Quartal auf minus 29 Millionen Euro gegenüber einem Minus von 81 Millionen Euro im Vorquartal und einem Minus von 40 Millionen Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der geringere Verlust reflektiert hauptsächlich geringere Kosten für unausgelastete Produktionskapazitäten und niedrigere Restrukturierungskosten.

Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung reduzierten sich im ersten Geschäftsquartal auf 276 Millionen Euro oder 17 Prozent vom Umsatz. Im Vorquartal lag dieser Wert noch bei 297 Millionen Euro oder 17 Prozent vom Umsatz. Der Rückgang resultierte hauptsächlich aus geringeren F&E-Kosten im Geschäftsbereich Speicherprodukte sowie aus im Vorquartal noch auftretenden Kosten für nicht abgeschlossene F&E-Projekte im Geschäftsbereich Automobil- und Industrieelektronik.

EBIT	3 MONATE ZUM	
	30.09.03	31.12.03
	in Mio. Euro	
Drahtgebundene Kommunikation	-8	-15
Sichere Mobile Lösungen	4	14
Automobil- und Industrieelektronik	44	48
Speicherprodukte	134	57
Sonstige und Konzernfunktionen	-107	-34
Infineon Konzern	67	70

Die Entwicklungen der einzelnen Geschäftsbereiche waren im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2004 gegenüber dem vorausgegangenen Quartal und dem vergleichbaren Vorjahresquartal wie folgt:

Restrukturierungen der zuvor von Ericsson übernommenen Sparte Microelectronics konnte der Geschäftsbereich zudem Kostensenkungen erzielen.

Die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten betragen 174 Millionen Euro oder 11 Prozent vom Gesamtumsatz gegenüber 185 Millionen Euro oder 11 Prozent vom Gesamtumsatz im Vorquartal. Der Rückgang in absoluten Zahlen ist im Wesentlichen auf geringere Kosten für externe Dienstleister sowie Maßnahmen zur Kostenkontrolle zurückzuführen.

Liquidität

Die Brutto-Cash-Position (Zahlungsmittel, Wertpapiere des Umlaufvermögens und als Sicherheitsleistungen hinterlegte Zahlungsmittel) von Infineon blieb im letzten Quartal unverändert bei 2,8 Milliarden Euro. Die Netto-Cash-Position (Brutto-Cash-Position abzüglich Finanzverbindlichkeiten) stieg von 328 Millionen Euro am Ende des Vorquartals auf 355 Millionen Euro.

Geschäftsentwicklung

Infineon hat seinen ersten NAND-kompatiblen Flash-Chip erfolgreich auf den Markt gebracht und mit einem 512-Megabit-Speicherchip auf Basis der Twin-

Flash-Technologie erstmals ein Produkt für den Markt der Flash-Speicher eingeführt. Die Produktion dieser Chips hat das Unternehmen in die 200-mm-DRAM-Fertigungslinie in Dresden aufgenommen. Darüber hinaus hat Infineon Muster seiner Mobile-RAM-Bausteine mit Speicherdichten von 128 und 256 Megabit sowie 500-Mega-Hertz-DDR-3-Grafik-RAM-Bausteine ausgeliefert, die alle auf der 110-Nanometer-Technologie des Unternehmens basieren. Inotera Memories Inc., das Joint Venture von Infineon mit dem taiwanischen Unternehmen Nanya, hat im Dezember 2003 mit der Installation des 300-mm-Fertigungsequipments begonnen.

Entsprechend der langfristigen Regionalstrategie dieses Geschäftsbereichs konnte die Automobilsparte – insbesondere in den Ländern der nordamerikanischen Freihandelszone (NAFTA) – wichtige Design-Wins mit applikationsspezifischen Chipsätzen für Sicherheitsanwendungen und den Antriebsstrang verzeichnen. Die Industrieparte des Geschäftsbereichs hat erfolgreich die neue LightMOS-IGBT-Produktfamilie eingeführt und damit ihr Portfolio im Markt für elektronische Lampenvorschaltgeräte komplettiert.

Im Bereich Zugangsnetzprodukte verzeichnete das Geschäft mit ADSL- und SHDSL-Lösungen ein beträchtliches Umsatzwachstum. Hinzu kamen wichtige Design-Wins bei führenden Kunden wie Siemens ICN.

Bei Mobilfunkkomponenten wie Baseband- und RF-Produkten sowie Produkten für Plattformlösungen verzeichnete der Geschäftsbereich weiterhin eine hohe Nachfrage. Zudem erreichte der Auftragszugang für Diskrete Halbleiter das höchste Niveau der vergangenen fünf Quartale. Bei Sicherheitslösungen hat das Unternehmen erfolgreich neue Projekte für elektronische Ausweise und Führerscheine gestartet. Um die Entwicklung vom Halbleiterhersteller zum Systempartner für komplette mobile Plattformlösungen zu beschleunigen, hat Infineon im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2004 die Übernahme von rund 145 Software-Entwicklern von Siemens ICM vereinbart. Damit hat Infineon sein Know-how beim marktführenden Protocol Stack für Siemens-Mobiltelefone (hardwarenahen Software-Lösungen für das Funkteil eines Handys) ausgebaut.

AUSBLICK AUF DAS GESCHÄFTSJAHR 2004

Sämtliche Geschäftsindikatoren zeigen, dass sich die Halbleiterindustrie nun endlich in einer Aufschwungphase befindet. Die schlimmste Krise, die der Halbleitermarkt jemals erlebt hat, scheint vorüber. Angesichts der Markterholung sehen auch wir eine positive Geschäftsentwicklung für das laufende Geschäftsjahr. Wir erwarten für alle Segmente ein stabiles Wachstum im Jahr 2004.

Trotz des anhaltenden starken Preisdrucks erwartet Infineon angemessenes Wachstum in seinem Automobilsegment, das die Einführung neuer Automodelle mit einem höheren Halbleiteranteil und ein begrenztes Wachstum der weltweiten Automobilproduktion widerspiegelt.

Obwohl der schwache US-Dollar die Geschäftsentwicklung beeinflussen wird, geht das Unternehmen von einem Wachstum entsprechend der positiven Marktentwicklung für seinen Geschäftsbereich Automobil- und Industrieelektronik im Geschäftsjahr 2004 aus.

Infineon geht davon aus, dass das Segment Drahtgebundene Kommunikation im zweiten Quartal des Geschäftsjahrs 2004 zu einem Umsatzwachstum zurückkehrt. Dies könnte jedoch durch eine weitere Zunahme der Dollar-Schwäche beeinträchtigt werden. Für das Geschäftsjahr 2004 erwartet das Unternehmen ein solides Wachstum in diesem Geschäftsbereich. Darüber hinaus bereitet Infineon

strategische Optionen für sein Geschäft mit Glasfaserkomponenten vor, indem es die Sparte als eine separate Einheit ausgliedert. Das Unternehmen analysiert derzeit potenzielle strategische Partner, um die Performance des Geschäftswerts zu maximieren.

Im Segment Sichere Mobile Lösungen erwartet Infineon für das zweite Quartal auf Grund der saisonbedingt geringeren Nachfrage nach dem Weihnachtsgeschäft und des weitergehenden Auslaufs von Teilen des Geschäfts mit schnurlosen Telefonen einen leichten Umsatzrückgang gegenüber dem abgelaufenen Quartal. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich das Geschäft in den Segmenten Mobilfunkinfrastruktur und Diskrete Halbleiter stabil

FORTSETZUNG AUSBLICK AUF DAS GESCHÄFTSJAHR 2004

entwickeln wird. Infineon ist zuversichtlich, dass die Nachfrage nach Sicherheits-Controllern bis zum Ende des Geschäftsjahrs 2004 kontinuierlich weiter zunehmen wird; hauptsächlich in Folge wichtiger Design-Wins bei Projekten zur Identifikation. Die anhaltende Konvergenz von Multimedia-Applikationen sollte das Wachstum im Geschäft mit mobilen Lösungen im Verlauf der zweiten Hälfte des Geschäftsjahrs 2004 zusätzlich stärken.

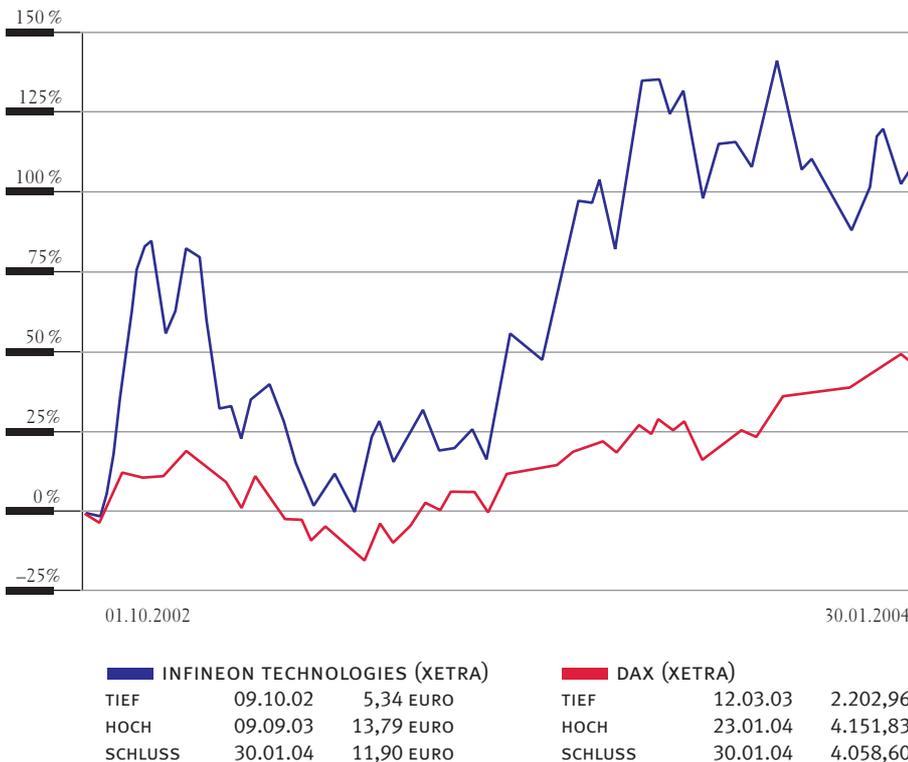
Traditionell ist der Kalenderjahresanfang durch einen Rückgang der Preise von Speicherprodukten gekennzeichnet, da die PC-Nachfrage nach der Weihnachtssaison rückläufig ist. Infineon erwartet einen Anstieg seiner Bit-Nachfrage im zweiten

Quartal. Das hauptsächliche Produktionswachstum im restlichen Geschäftsjahr wird bestimmt durch die Umstellung der Fertigungsanlagen auf die 110-Nanometer-Technologie und den Hochlauf der Fertigungskapazitäten bei den Partnerunternehmen. Im Jahr 2004 wird die Nachfrage voraussichtlich zunehmen, da Unternehmen ältere Systeme ersetzen, sowie durch den zunehmenden Einsatz von mit DDR-II-Modulen ausgestatteten Desktop-PCs und Servern.

Trotz des anhaltenden Preisdrucks in den meisten unserer Geschäftsbereiche sehen wir zunehmend deutliche Anzeichen einer Erholung der Halbleiterindustrie. Dazu gehören insbesondere die stark

ansteigende Auslastung unserer eigenen Fertigungsanlagen und der unserer Produktionspartner sowie ein höherer Auftragseingang von unseren Kunden. Obwohl wir vorsichtig optimistisch sind, werden wir auch weiterhin Kosten reduzieren und unser Produktportfolio fokussieren, um flexibler und schneller als unsere Wettbewerber agieren zu können. Daher sind wir zuversichtlich, dass wir mit diesem Engagement erneut schneller als der Markt wachsen und unsere Profitabilität im Verhältnis zu den Benchmarks der Industrie weiter verbessern.

Relative Performance der IFX-Aktie seit Beginn des Geschäftsjahrs 2003 (auf Basis der Wochen-Schlusskurse, geglättet)



Hinweis:

Dieses Dokument enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Infineon beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u. a.: Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Infineon ist weder geplant noch übernimmt Infineon die Verpflichtung dazu.

INFINEON KALENDER

- 21.04.04 Veröffentlichung der Ergebnisse für das 2. Quartal und die ersten sechs Monate (bis 31. März) des Geschäftsjahrs 2004
- 20.07.04 Veröffentlichung der Ergebnisse für das 3. Quartal und die ersten neun Monate (bis 30. Juni) des Geschäftsjahrs 2004
- 09.11.04 Jahrespressekonferenz 2004, Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2004 inkl. des 4. Quartals (bis 30. September 2004)

**IMPRESSUM
INVESTOR NEWSLETTER 7/2004**

Herausgeber
Infineon Technologies AG
Investor Relations und
Finanzkommunikation
Postfach 80 09 49
81609 München
Tel.: +49 89 234-26655
Fax: +49 89 234-9552987
E-Mail: investor.relations@infineon.com
www.infineon.com/boerse
Redaktion
Investor Relations